



- 1) Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lötstoplack
PC board total thickness with conductor paths and solder resist
- 2) Toleranz für Fräskante: 13 ± 0.2
tolerance for milled edge: 13 ± 0.2
- 3) Toleranz für Bohrungsabstand ($\phi 2 \pm 0.05$): 13 ± 0.1
tolerance for hole pitch ($\phi 2 \pm 0.05$): 13 ± 0.1
- 4) restliche Bauteilehöhe max. 0.8 mm
remaining component height max. 0.8 mm

Versatz / displacement	Toleranz / tolerance
Fräskante zu Bohrungen milled edge to holes	± 0.2
Fräskante zu Leiterbild milled edge to conductive pattern	± 0.3
Ritzkante zu Bohrungen score edge to holes	± 0.3
Bohrungen holes	± 0.1
Bohrungen zu Leiterbild holes to conductive pattern	± 0.15

				Tol.		Massstab 5:1				
				Datum	18.01.11	Modul HSM100 module HSM100				
				Bearb.	Grassl					
				Gepr.	SK 03.12.2014					
				Norm.						
				EnOcean GmbH		A55-C01			Blatt 1-	
									X Bl.	
1	-----	XX.XX.XX	Gra.							
Zust.	Mitteilung	Datum	Name							